【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和6年8月28日(2024.8.28)

【公開番号】特開2024-79447(P2024-79447A)
【公開日】令和6年6月11日(2024.6.11)
【年通号数】公開公報(特許)2024-107
【出願番号】特願2022-192415(P2022-192415)
【国際特許分類】
Ａ６３Ｆ 7/02(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ６３Ｆ 7/02 ３２６Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和6年8月20日(2024.8.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の電子部品が実装される複数の基板を備える遊技機であって、
前記複数の基板は、
遊技の進行に関わる処理を実行する主制御手段を備える第１基板と、
該第１基板よりも前側に配置される第２基板と、を備え、
前記第１基板の表基板面には、絶縁被膜が形成されるとともに、該絶縁被膜上に複数の前記電子部品それぞれを特定する表記部が形成され、
前記第２基板の表基板面には、絶縁被膜が形成されるものの、該絶縁被膜上に複数の前記電子部品それぞれを特定する表記部は形成されず、
前記第１基板にはベタグランドパターンが形成され、前記第２基板にはベタグランドパターンが形成されないものであり、
前記第１基板の表基板面には、表面実装タイプの電子部品と、挿入実装タイプの電子部品と、が実装されて、少なくとも前記表面実装タイプの電子部品がハンダ付けされる複数の接続部のうちの特別接続部と、前記ベタグランドパターンと、を接続する特別パターンが形成されており、
前記第１基板の裏基板面にも前記ベタグランドパターンが形成され、
前記特別パターンは、前記特別接続部から延設される複数の配線パターンからなる
ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
請求項１に係る発明によれば、
複数の電子部品が実装される複数の基板を備える遊技機であって、
前記複数の基板は、
遊技の進行に関わる処理を実行する主制御手段を備える第１基板と、
該第１基板よりも前側に配置される第２基板と、を備え、

前記第１基板の表基板面には、絶縁被膜が形成されるとともに、該絶縁被膜上に複数の前記電子部品それぞれを特定する表記部が形成され、

前記第２基板の表基板面には、絶縁被膜が形成されるものの、該絶縁被膜上に複数の前記電子部品それぞれを特定する表記部は形成されず、

前記第１基板にはベタグランドパターンが形成され、前記第２基板にはベタグランドパターンが形成されないものであり、

前記第１基板の表基板面には、表面実装タイプの電子部品と、挿入実装タイプの電子部品と、が実装されて、少なくとも前記表面実装タイプの電子部品がハンダ付けされる複数の接続部のうちの特別接続部と、前記ベタグランドパターンと、を接続する特別パターンが形成されており、

前記第１基板の裏基板面にも前記ベタグランドパターンが形成され、

前記特別パターンは、前記特別接続部から延設される複数の配線パターンからなる

ことを特徴とする。